

BUSINESS REPORT 2019

第40期 年次報告書
2018.08.01 ▶ 2019.07.31



samco
サムコ 株式会社

証券コード 6387

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
上場市場	東京証券取引所市場第一部
配当金支払株主確定日	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
公 告 方 法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたし ます。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホーム ページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご紹介

最新のトピックスをはじめ、財務情報や会社情報を掲載しております。製品・アプリケーションの紹介や広報誌「samco NOW」など、掲載内容を充実させております。当社をご理解いただきためにもぜひアクセスしてください。

<https://www.samco.co.jp/>



トップページ

samco



令和元年10月
左：代表取締役社長兼COO 川邊 史
右：代表取締役会長兼CEO 辻 理

以上の結果、当期における業績は、売上高が4,936百万円（前期比9.7%減）、営業利益は327百万円（前期比48.6%減）、経常利益は305百万円（前期比52.5%減）、当期純利益は215百万円（前期比47.1%減）となりました。

第41期の見通し

当期末の受注残高は2,077百万円（前期比2.8%増）であり、オプトエレクトロニクス分野では通信系レーザー用途、電子部品分野ではパワーデバイス、各種センサー用途等で商談が進んでおります。また、実装・表面処理分野では引き続きアクアプラズマを重点製品として販売活動を推進しております。

以上の取り組みにより、第41期の売上高は6,200百万円（前期比25.6%増）、営業利益は750百万円（前期比128.8%増）、経常利益は720百万円（前期比136.0%増）、当期純利益は490百万円（前期比127.3%増）となる見込みであります。

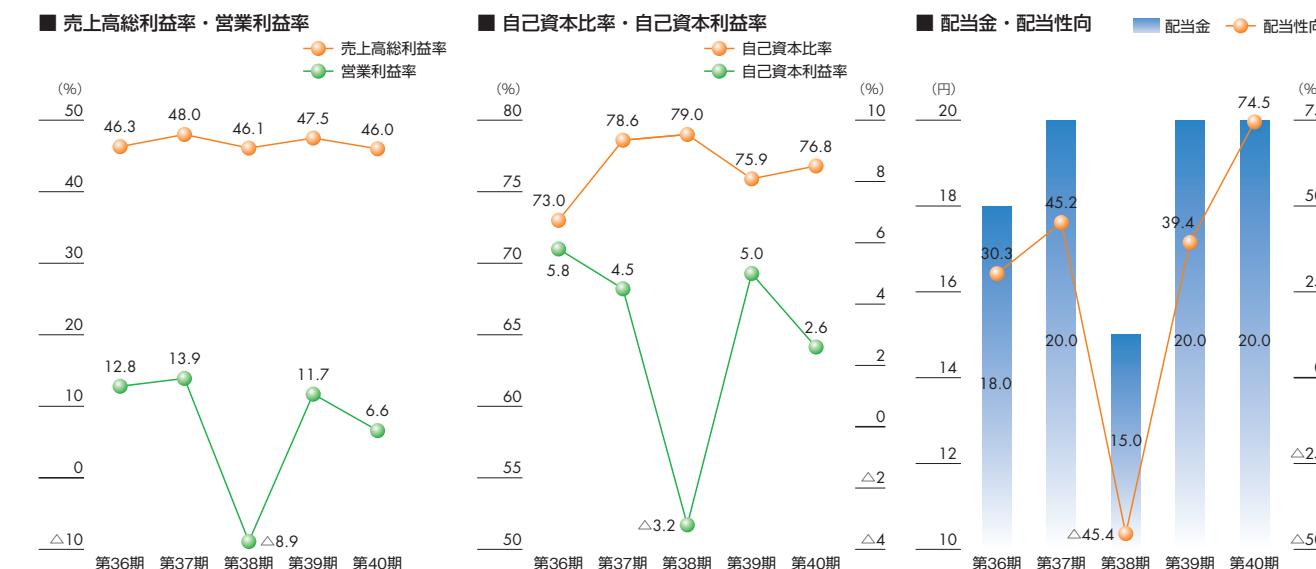
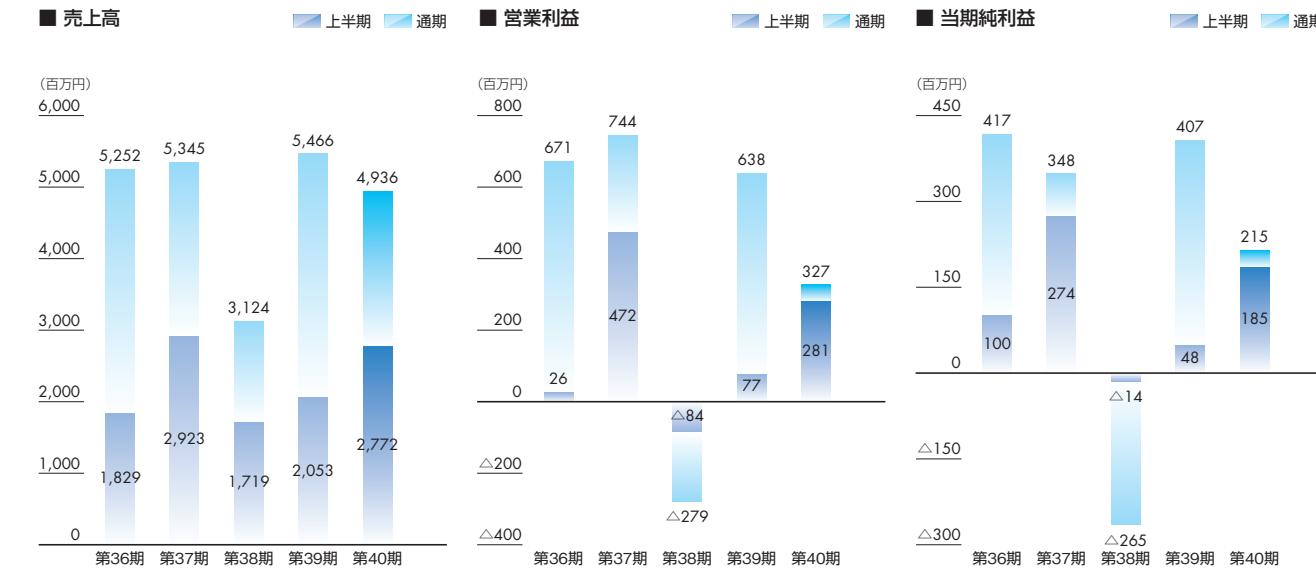
株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

当社第40期（平成30年8月1日～令和元年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

当期（第40期）の事業環境と経営成績

当期、当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、当社の関わる化合物半導体および電子部品製造装置の販売マーケットにおいて、新たなモバイル機器や車載センサーなどの電子部品分野、あるいはMEMS（Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子）といった先端分野での研究開発投資が幅広い企業で進み、その中から本格生産への移行も進んでおります。

このような状況の下、前期（平成30年7月期）に引き続き、オプトエレクトロニクス分野の通信用レーザーや、電子部品分野の高周波デバイス、パワーデバイス、MEMS、各種センサー等向け製造装置の受注活動、新製品の拡販に注力してまいりました。しかしながら、スマートフォン市場の需要低迷および米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速が、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資判断に影響していることにより、受注高は伸び悩みの傾向が続きました。その結果、国内売上高は3,161百万円（前期比1.9%減）、輸出販売高は1,774百万円（前期比20.9%減）となりました。





品目別販売状況

■ エッチング装置
売上高 2,801百万円
前期比 15.9%減

電子部品分野のセンサー向けとパワーデバイス向けの販売が拡大した一方で高周波フィルタ向けの販売が落ち込み、売上高は2,801百万円となりました。

■ CVD装置
売上高 429百万円
前期比 52.5%減

前期に好調であったオプトエレクトロニクス分野の生産用のLD向けの販売が振るわず、売上高は429百万円となりました。

■ 洗浄装置
売上高 762百万円
前期比 52.0%増

オプトエレクトロニクス分野の生産用のLD向けと電子部品分野の生産用のパワーデバイス向けの好調により、売上高は762百万円となりました。

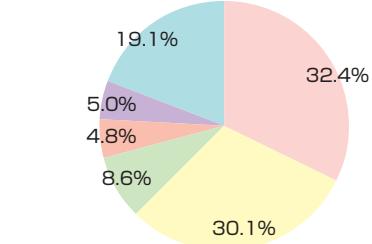
■ その他
売上高 942百万円
前期比 29.5%増

既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造作業などで、売上高は942百万円となりました。

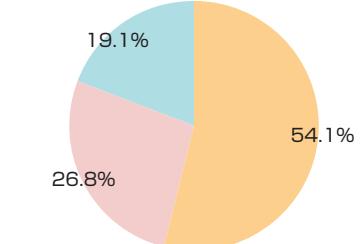
売上高割合状況

売上高 4,936百万円	前期比 9.7%減
--------------	-----------

用途別売上高割合



目的別売上高割合



- 電子部品分野
- オプトエレクトロニクス分野
- シリコン分野
- 実装・表面処理分野
- その他分野
- 部品・メンテナンス

サムコの製品

エッチング装置



ICPエッチング装置
半導体基板上の薄膜を微細に加工する装置です。反応性の気体をプラズマ分解し、半導体基板の目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社は複数の元素を材料にしている化合物半導体の加工を得意としており、次世代パワーデバイスの材料である窒化ガリウム(GaN)や炭化シリコン(SiC)などの加工が可能です。

微細加工分野

CVD装置



液体ソースCVD®装置
反応性の気体を半導体基板上に供給し、プラズマなどで化学反応させることで薄い膜を堆積させる装置です。半導体を水分やほこりから保護したり、絶縁性を持たせたりする目的で使用されます。当社は独自の原料を用いた液体ソースCVD®(Chemical Vapor Deposition=化学気相成長)法に特長があり、比較的低温での高速成膜が可能です。

薄膜形成分野

洗浄装置

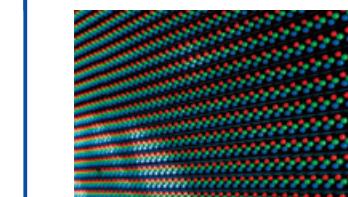


プラズマクリーナー
液体を用いないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて半導体基板の表面を洗浄します。独自に開発したAqua Plasma®は銀や銅の表面還元や樹脂の接合など幅広い分野に応用されています。また、紫外線(UV)とオゾン(O₃)を用いたUVオゾンクリーナーも取り揃えています。

洗浄・表面処理分野

サムコの事業分野

オプトエレクトロニクス分野



照明や光通信に使われるLEDやLDなどの発光デバイス

電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりするデバイスで、主に化合物半導体で作られています。自動車のヘッドライトに用いられる高輝度LEDやLD、データセンターで用いられる近距離通信用のLDや光導波路などのデバイスがあります。



電子部品分野



IoT(Internet of Things)を支えるキーデバイス

各種センサー・MEMS (Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子)・高周波フィルタなどの分野です。スマートフォンに多数搭載される高周波フィルタは、IoT時代を迎えその応用製品が飛躍的に増加しています。



実装・表面処理分野



電子機器の小型化、軽量化および高機能化を実現する重要なプロセス

パッケージ工程前のドライ洗浄分野です。最先端パッケージとして注目が高まるファンアウトウエハーレベルパッケージ(FOWLP)をはじめ、高機能な電子機器を製造するための信頼性の高い洗浄が要求されます。



貸借対照表

科 目		当 期 (令和元年7月31日現在)	前 期 (平成30年7月31日現在)	科 目		当 期 (令和元年7月31日現在)	前 期 (平成30年7月31日現在)
(資 産 の 部)							
流 動 資 産		7,284,619	7,314,730	(負 債 の 部)		1,678,271	1,817,839
現 金 及 び 預 金		4,807,657	4,201,150	流 動 負 債		493,182	547,843
受 取 手 形		36,720	91,768	買 掛 金		700,000	700,000
電 子 記 録 債 権		98,900	555,554	短 期 借 入 金		107,824	105,448
売 掛 金		1,195,426	1,546,348	未 払 費 用		32,497	32,442
た な 卸 資 産		1,095,232	842,529	未 払 法 人 税 等		17,901	160,532
そ の 他		50,819	77,601	前 受 金		222,559	157,730
貸 倒 引 当 金		△ 138	△ 222	預 り 金		29,307	47,250
固 定 資 産		3,499,439	3,593,746	賞 与 引 当 金		24,600	24,400
有 形 固 定 資 産		3,035,084	3,065,870	役 員 賞 与 引 当 金		3,106	9,672
建 物		332,387	364,172	製 品 保 証 引 当 金		25,700	23,500
構 築 物		898	1,143	そ の 他		21,592	9,018
機 械 及 び 装 置		76,102	79,625	負 債 合 計	2,503,119	2,630,337	
車両 運 搬 具		12,221	8,164	(純 資 産 の 部)			
工 具、器 具 及 び 備 品		22,929	25,191	株 主 資 本	8,220,347	8,165,462	
土 地		2,530,836	2,530,836	資 本 金	1,663,687	1,663,687	
リ 一 ス 資 産		16,085	23,130	資 本 剰 余 金	2,079,487	2,079,487	
建 設 仮 勘 定		43,623	33,606	資 本 準 備 金	2,079,487	2,079,487	
無 形 固 定 資 産		15,999	13,985	利 益 剰 余 金	4,487,976	4,433,025	
投 資 そ の 他 の 資 産		448,355	513,890	利 益 準 備 金	59,500	59,500	
投 資 有 価 証 券		147,971	217,839	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,428,476	4,373,525	
関 係 会 社 株 式		25,207	25,207	別 途 積 立 金	3,867,000	3,867,000	
緑 延 税 金 資 産		130,268	124,860	繰 越 利 益 剰 余 金	561,476	506,525	
そ の 他		144,907	145,983	自 己 株 式	△ 10,803	△ 10,737	
				評 価 ・ 換 算 差 額 等	60,591	112,676	
				そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	60,591	112,676	
				純 資 產 合 計	8,280,939	8,278,139	
				負 債 ・ 純 資 產 合 計	10,784,058	10,908,476	
資 产 合 計		10,784,058					

単位：千円（未満切り捨て）

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (自平成30年8月1日 至令和元年7月31日)	前 期 (自平成29年8月1日 至平成30年7月31日)
売 上 高	4,936,132	5,466,483
売 上 原 価	2,665,630	2,870,429
売 上 総 利 益	2,270,501	2,596,054
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,942,752	1,957,799
營 業 利 益	327,749	638,254
營 業 外 収 益	23,858	15,862
營 業 外 費 用	46,499	11,366
經 常 利 益	305,108	642,751
特 別 損 失	—	78,811
税 引 前 当 期 純 利 益	305,108	563,939
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	72,009	134,690
法 人 税 等 調 整 額	17,481	21,329
当 期 純 利 益	215,617	407,919

単位：千円（未満切り捨て）

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (自平成30年8月1日 至令和元年7月31日)	前 期 (自平成29年8月1日 至平成30年7月31日)
営 業 活 動 に 由 る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	857,760	△ 223,892
投 資 活 募 に 由 る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 396,899	23,240
財 務 活 募 に 由 る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 171,176	△ 228,264
現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額	△ 22,585	△ 3,296
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額	267,098	△ 432,212
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高	2,486,070	2,918,283
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高	2,753,168	2,486,070

Point ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：売上債権の減少862,622千円、税引前当期純利益305,108千円、減価償却費92,716千円、前受金の増加64,828千円。

マイナス要因：たな卸資産の増加239,148千円、法人税等の支払202,474千円、仕入債務の減少54,660千円、預り金の減少17,943千円。

Point ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：定期預金の払戻による収入3,047,914千円、貸付金の回収による収入58,542千円。

マイナス要因：定期預金の預入による支出3,398,147千円、有形固定資産の取得による支出69,896千円、貸付けによる支出33,522千円。

Point ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー

マイナス要因：配当金の支払160,667千円、リース債務の返済による支出10,443千円。

Point ▶ 売上高

スマートフォン市場の需要低迷及び米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速を背景に、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資意欲が低下。売上高は前期比9.7%減の4,936,132千円。

国内の売上高は、前期比1.9%減の3,161,327千円。

海外の売上高は、前期比20.9%減の1,774,805千円。

Point ▶ 販売費及び一般管理費

賞与、試験研究費等の減少により前期比0.8%減の1,942,752千円となつたが、販管費率は前期の35.8%から39.4%へ3.6ポイント増加。

Point ▶ 営業外費用

前期は円高による為替差損が7,094千円発生、当期は円高がさらに進行し、為替差損は41,296千円へ拡大。

Point ▶ 損益分岐点

損益分岐点売上高は4,222,421千円。

中期経営計画

当社は、化合物半導体および電子部品製造用の製造装置を主力製品とし、研究開発機市場と生産機市場それぞれで事業を開しております。当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という経営理念のもと、研究開発型企業として成長してきた高度な技術力を維持すると同時に、蓄積した技術を生産機市場で活かすことで、事業規模の拡大を図っております。加えて、当社のコアテクノロジーである「薄膜技術」は医療、バイオ、環境といったライフサイエンスおよびエネルギー分野に活かすことが可能であり、中期的には当社の新規事業、新分野として成長させることを目指しております。

当社の主たる事業領域である化合物半導体および電子部品製造装置のマーケットでは、世の中に存在する様々なモノがネットワークと繋がるIoT（モノのインターネット）、自動運転、ロボット、AI（人工知能）等の技術革新の時代が本格的な幕開けを迎えつつあり、関連企業は設備投資に対して前向きな姿勢を示しております。令和元年8月よりスタートさせた中期経営計画において、当社の新たな成長に向けた中長期ビジョンを作成し、以下の課題に取り組んでおります。

課題

1. 海外販売の拡大

当社の事業を成長軌道に乗せるため、海外販売の拡大を最大の目標に掲げ、将来の成長期待の高い海外への事業展開を積極的に行っております。海外拠点、販売・サービス体制の整備と充実を図り、引き続き海外市场の開拓を図っていく方針であります。台湾、中国、韓国の既存主要顧客との繋がりを維持、強化しながら、北米、欧州、インド等の新たなマーケットの確立により、当面は海外売上高比率50%以上の達成を目指してまいります。

2. 成膜装置販売の拡大

当社の属する半導体等電子部品製造装置市場は、常に技術開発の競争、顧客ニーズの多様化や高度化、グローバル化が加速しており、継続的な研究開発活動による高付加価値・高機能製品の開発、新製品の市場投入を進めることで、市場での競争力を維持し続けることが命題であります。

近年では、ドライエッティング装置のRIE-200iPNや、洗浄装置のアクアプラズマクリーナーの新製品を開発、販売をしてまいりましたが、今後は既存の製品群の中から、特に成膜装置（CVD装置、ALD装置等）の販売拡大を目的とした施策を行ってまいります。顧客ニーズに合わせた新製品の開発、成膜装置の性能向上による競争力の強化、製品ラインナップの見直し、本社研究開発センターのデモ拠点の整備等の施策を図ってまいります。

3. 新規事業の立ち上げ

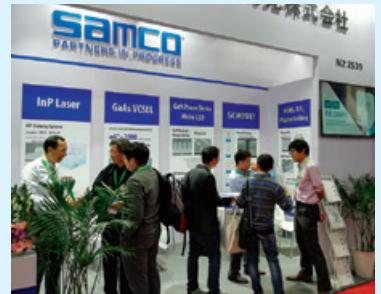
現在の製品群であるCVD装置、エッティング装置、洗浄装置を新たな事業領域へ展開し、新規事業として業績への寄与を目指しております。具体的には、第38期よりヘルスケア分野へ進出し、医療分野における滅菌装置の開発および医療計測分野におけるヘルスケアチップの加工装置の開発・販売を行っております。

また、新たなマーケット開拓のため、本社研究開発センター、米国オプトフィルム研究所での研究開発、国内外の大学や各種クラスターとの共同研究の継続により、薄膜事業に関連する新規事業を創出し、成長を加速させてまいります。

以上の課題を克服し、第41期は売上高6,200百万円、第42期は7,400百万円、第43期は7,800百万円という中期経営計画の目標達成を目指します。

○国内外の展示会に積極的に出展

当社は世界各地のセミコンショーやオプトエレクトロニクス分野などの展示会にはほぼ毎月出展しております。2019年7月期下期には、セミコンショーやでは3月に上海で開催されました『SEMICON China 2019』、5月にマレーシアのクアラルンプールで開催されました『SEMICON Southeast Asia 2019』、7月にサンフランシスコで開催されました『SEMICON West 2019』に出



SEMICON China 2019



SEMICON West 2019

展いたしました。そのほか、4月に米国ミネアポリスで開催されました『CS Mantech』、5月に奈良で開催されました『化合物半導体週間』といった化合物半導体分野の展示会に出展いたしました。7月には東京で開催されました当社の新規事業分野であるヘルスケア分野の『ファーマラボ』に初出展いたしました。

○個人投資家向け会社説明会を開催

去る6月18日、大阪・堺筋本町（ENDO堺筋会議室）で開催されましたマルサントレードIRセミナーにおきまして、当社は個人投資家を対象としました会社説明会を行いました。当社の事業内容や今後の見通し等について代表取締役社長兼COOの川邊史よりご説明いたしました。

○サムコ科学技術振興財団が2019年度 第3回研究助成者5名を決定

サムコ科学技術振興財団は、6月13日に第3回 薄膜技術に関する研究助成の対象者5名を決定いたしました。助成対象者5名には、9月6日に開催されました研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額1,000万円が贈呈されました。式典後には、理化学研究所理事長の松本紘先生（前京都大学総長）による記念講演が行われました。

※研究助成対象者5名とその研究課題につきましては財団のホームページをご覧ください。

<https://www.samco.co.jp/foundation/prize/>





■ 会社概要

商 号 サムコ株式会社
英 文 社 名 SAMCO INC.
設 立 昭和54年（1979年）9月
事 業 内 容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入

資 本 金 1,663,687,288円
従 業 員 数 170名
本 社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地
TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936

国 内 拠 点 本社（京都）、東日本営業部（東京）、
東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）、
福岡営業所（福岡）

海 外 拠 点 米国（カリフォルニア・ニュージャージー）、
台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、韓国、
マレーシア

研 究 拠 点 本社研究開発センター（京都）、
オプトフィルム研究所（米国）

■ 役員

代表取締役会長兼CEO	辻 理
代表取締役社長兼COO	川 邊 史
取締役副社長	石 川 詞念夫
取締役常務執行役員	竹之内 聰一郎
取締役執行役員	山 下 晴彦
社外取締役	村 上 正紀
常勤監査役	小 林 弘明
社外監査役	辻 村 茂
執行役員	木 村 隆之
	西 尾 方宏
	関 仲 修
	久保川 泰彦
	ピーター・ウッド
	本 山 慎一
	佐 藤 清志

■ 株式の状況

発行可能株式総数 14,400,000株
発行済株式の総数 8,042,881株
株主数 7,398名

■ 大株主の状況

株 主 名	持株数(株)	持株比率(%)
辻 理	1,005,907	12.5
サムコエンジニアリング(株)	920,282	11.4
(財)サムコ科学技術振興財団	800,000	9.9
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	205,500	2.6
辻 一美	201,465	2.5
サムコ従業員持株会	200,138	2.5
辻 猛	190,015	2.4
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	160,100	2.0
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
京都中央信用金庫	120,000	1.5

■ 所有者別株式分布状況

